

講演発表募集

「第31回学生会員卒業研究発表講演会」

－ 今後の精密工学を担う萌芽的研究 －

第31回「学生会員卒業研究発表講演会」を下記のとおり、対面にて開催いたします。学生会員卒業研究発表講演会の趣旨は若手会員の学会への参加意識を高めると同時に、学生に経験を積ませ育成することにあります。なお本会の趣旨により、発表する卒業研究の内容は、精密工学に関係したものとし、発表する学生は学部および工業高専の最終年次に所属し、精密工学会の学生会員（学生会員 web 級含む）であることを条件とします。また、卒業研究発表論文集に掲載された論文は工作機械技術振興財団の工作機械技術振興賞（奨励賞）の審査対象となる可能性があり、毎年1～2名が受賞しています。大会の正式行事として実施いたしますので、学生会員（学生会員 web 級含む）の皆さまの参加を期待しております。

1. 開催日 2024年3月12日（火）

2. 会場 東京大学 本郷キャンパス（東京都文京区本郷 7-3-1）

3. 発表申込期間 2023年12月19日（火）9時～2024年1月12日（金）正午まで（締切厳守）

4. 講演論文原稿締切 2024年2月1日（木）正午（締切厳守）

5. 講演論文集公開予定 2024年3月5日（火）（「学生会員卒業研究発表講演会講演論文集」学会ウェブサイト公開日）

6. 本講演会について

本講演会は、すべて対面でのセッションとなり、発表プログラムに沿って会場講演室で発表・質疑応答を行います。

7. 発表申込について

1) 発表申込は締切日までに発表申込受付サイトから行ってください。申込締切後、直ちに作業を進めますので、遅れたものは受付できません。

問合せ先：公益社団法人 精密工学会 大会係 E-mail: jspe_taikai@jspe.or.jp

2) 発表者は学生会員（学生会員 web 級含む）に限ります。学会へ未入会の場合は、発表申込と同時にまたはそれ以前に入会手続きをしてください。なお、発表者を筆頭に申し込んでいただきますが、発表原稿での著者の順番は、これに従う必要はありません。また、指導者と連名での申込みを原則とします。

3) 発表申込金 ¥5,500（税込）

4) 講演論文原稿は「学生会員卒業研究発表講演会 PDF 原稿の書き方・見本」を参照のうえ作成して、締切日までに指定のウェブページから提出してください。

5) 発表申込期間を過ぎた後の発表の取消しは参加者に多大な迷惑をかけ、大会実行委員会ならびに本講演会担当委員会が準備を進めるうえでも支障をきたしますので、発表取消は行わないよう注意願います。

6) 卒業研究発表講演会講演論文および口頭発表に用いる言語は日本語または英語とします。

7) 学生会員卒業研究発表講演会講演論文集に掲載された論文の著作権および要旨集に掲載される概要の著作権は公益社団法人精密工学会に帰属します。本会の著作権は複製権、翻案権、翻訳権を含みます。

8. 発表申込の入力要領

1) 同一題目の第1報～第n報には必ず副題を入れてください。

2) 要旨は発表プログラム編成の際参考とするものです。また要旨集に掲載します。内容（要点）を簡潔に記入して下さい。

3) 本講演会におけるプログラム分類・コード・キーワードの入力については、別紙一覧表から発表内容にふさわしいキーワードを選択し、その分類・コードを所定欄に入力してください。

9. 発表形式

本講演会の発表形式は、学術講演会に準ずるものとします。発表1件あたりの講演時間は15分です（発表最大10分、討論、発表切替5分）。

10. 講演発表に関するお願い

- 1) 発表で使用可能な機器は液晶プロジェクタに限ります。なおパソコンは学会では準備いたしませんので、各自でご持参ください。パソコンは発表前に液晶プロジェクタに接続し、正常に出力されることを確認してください。接続時間も発表時間に含まれますので、十分な投影テストをお勧めします。プレゼンテーションソフトおよび液晶プロジェクタの特長を生かしたわかりやすい発表をするように心がけてください。
- 2) 発表当日に配布用として講演論文をA4用紙に印刷（2ページ原稿の場合は両面印刷）したものを、各自20部用意してください。

11. 発表プログラムについて

発表プログラムは、本講演会担当委員会であるアフィリエイト委員会が責任を持って決定いたします。

12. 評価について

評価は、各セッションの座長および審査員が、講演論文・発表・質疑応答に対して採点を行う方式で行います。また本講演会では特に、その趣旨に基づき、「発表者本人の研究への貢献度」を重要視します。そのため、研究内容・成果のうち、発表者本人が寄与した範囲はどの部分か明確になるように発表してください。

13. 表彰について

優秀な発表者に対しては「卒業研究発表講演会優秀講演賞」を贈ります。なお受賞者は学会ウェブサイトにて公表いたします。また、今回は企業の視点で優れていると判断された優秀な発表に対し、先端技術パネル・機器展示会に出展いただいた企業名を冠した「企業冠賞」を贈呈いたします。

締切日は厳守してください

発表申込期間を過ぎての題目、発表者の変更は原則として認めません

<分類表>

A：設計・生産システム

B：精密加工

C：メカトロニクス・精密機器

D：精密計測

E：人・環境工学

F：材料・表面プロセス

G：バイオエンジニアリング

H：ナノテクノロジー・新領域

分類	コード	キーワード
A	01	形状モデリングと製造支援, CAGD, エンジニアリングシミュレーション, コンピュータグラフィックス
A	02	意匠設計 (スタイルデザイン), リバースエンジニアリング, 3次元形状モデリング技術, 意匠形状評価技術
A	03	持続可能社会, ライフサイクル設計, ライフサイクルマネジメント, サステナブル・マニュファクチャリング
A	04	3次元環境計測データからのモデル構築, 大規模形状計測データに対する情報処理, フィールド計測技術 (画像, レーザなど), サイバーフィールドの利活用と業務支援
A	05	CAD, CAM, CAE, CAT, オープン開発, カーネル内製化
A	06	金型CAD/CAM/CAE, 金型加工, プラスチック成形加工, 塑性加工
A	07	群知能, 進化と学習, マルチエージェント, 複雑システム
A	08	設計プロセス, 設計手法, 設計教育, 設計モデル, 設計評価, サービス設計, PSS (Product-Service Systems, 製品サービスシステム), 設計論, 設計知識, 最適化, ロバスト設計, 信頼性設計, QFD(Quality Function Development), DFX(Design for X), プロダクトファミリー, VR(Virtual Reality)応用, 生産システム, 生産計画, 工程計画, サプライチェーン, 生産シミュレーション, スマートファクトリー
A	99	設計・生産システム一般
B	01	工作機械, 高速化, 高精度化, 高機能化
B	02	切削工具, 切削加工技術, 切削特性
B	03	多軸制御, 加工, 計測, 精度補正
B	04	穴加工, 穴精度測定, 掘削
B	05	超音波振動切削, 超音波振動研削, 超音波振動研磨
B	06	研削現象, 研削機構, 加工計測, 研削シミュレーション
B	07	超砥粒ホイール, 研削, ツルーイング・ドレッシング, 研削盤
B	08	曲面・微細加工, 超精密加工, 超精密計測
B	11	ポリッシング・ラッピング, 高平坦研磨加工, 固定砥粒研磨加工, 超精密研磨加工, メカノケミカル研磨加工, 噴射加工, 工作物の高精度保持
B	12	磁場・電場援用研磨 (加工), 電気・磁気粘性流体利用加工
B	13	プラナリゼーションCMP, 超精密研磨, 半導体材料, 消耗材技術 (スラリー・パッド・コンディショナー), 装置化技術, デバイスプロセス, 評価技術, ラッピング・ポリッシング, 鏡面・平坦化加工 (含む研削), 複合・援用研磨, 新研磨・仕上げ加工法, その他
B	14	放電加工, 電解加工, レーザ加工
B	15	レーザー加工, レーザ, 微細加工, 材料加工
B	16	切削機構, 切削温度, 工具摩耗, 仕上げ面評価, 切削状態監視, 知能化切削, 切削シミュレーション
B	17	付加製造, 3Dプリンティング, M I D
B	18	次世代研磨技術, 砥粒開発, 数値解析, 副資材開発, 砥粒再生技術
B	19	データサイエンス, AI, IoT, DX
B	99	精密加工一般

<分類表>

A：設計・生産システム

B：精密加工

C：メカトロニクス・精密機器

D：精密計測

E：人・環境工学

F：材料・表面プロセス

G：バイオエンジニアリング

H：ナノテクノロジー・新領域

分類	コード	キーワード
C	01	位置決め, 制御, 機構, センサ
C	02	機能性材料を応用したセンサ・アクチュエータ, 新原理によるセンサ・アクチュエータ, 超音波デバイスとその応用, センサ・アクチュエータ制御手法
C	03	ロボティクス, メカトロニクス, センサ, アクチュエータ
C	05	マイクロ工作機械, マイクロファクトリー, マイクロ組立, 生産システムの小型化, 微小部品加工
C	99	メカトロニクス・精密機器一般
D	01	光応用技術(三次元計測, 形状計測, 光センシング, 生体・医用計測, 高速度計測, 機器光学, オプトメカトロニクス), イメージング・光情報処理(光イメージング, デジタルオプティクス, 光物性), 光学新領域(プラズモン, テラヘルツ, X線, 中赤外等も含む)
D	02	知的計測
D	03	画像処理, 画像応用, 産業システム, 実利用, 知能化システム
D	04	X線光学系, X線イメージング, X線CT, X線非破壊検査装置, X線分析装置, X線リソグラフィ, X線検出器, X線顕微鏡, X線望遠鏡
D	99	精密計測一般
E	01	医用機器, 福祉機器, 人間共存型機器, 生活支援機器
E	02	技術者倫理, 生産哲学, モノづくり, 技術史, 工学教育, 技術伝承, 感性
E	99	人・環境工学一般
F	01	表面処理技術, 薄膜形成, 機能薄膜, 表面特性
F	99	材料・表面プロセス一般
G	01	マイクロニードル, ニードルアレイ, ニードルパッチ, 無痛針, MEMS, 微細加工, 医療応用
G	02	生体分子・細胞マニピュレーション, 生体分子・細胞機能解析, バイオイメージング, バイオアセンブリ, 細胞培養, バイオマテリアル, バイオ機能表面, バイオデバイス, バイオMEMS, マイクロTAS, 医用センサ, 医用マイクロメカニズム, 微細加工, 3Dバイオプリンティング
G	99	バイオエンジニアリング一般
H	01	微細加工, 超精密加工, 表面機能とその評価, トライボロジー
H	02	マイクロ/ナノシステム, マイクロメカニズム, マイクロマシン, マイクロ/ナノメカニズム, MEMS/NEMS, MOEMS/NEOMS, マイクロアクチュエータ, センサ, 光デバイス, マニファクチャリングシステム, アセンブリングシステム, デザインシステム
H	03	MEMS デバイス応用, デバイス・材料評価, MEMSデバイス作製技術, アセンブリ/パッケージング, マイクロ接合, ナノインプリント, 電子ビーム描画技術
H	04	ナノファブリケーション, ナノストラクチャー, プローブ顕微鏡
H	99	ナノテクノロジー・新領域一般